

令和2年9月吉日

会社名株式会社
ご担当者名様

2021 IEEE International Interconnect Technology Conference
実行委員長 上野和良

2021 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC) ;

2021年多層配線技術国際会議へのスポンサーの募集について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

IoT・AIの飛躍的發展を支える ULSI の多層配線技術および TSV・3次元構造を含む実装技術は、配線材料の物性や構造のみならず、それらの選択、インテグレーション手法、信頼性評価、さらには、将来の配線技術の候補となる ERM (Emerging Research Materials) など、多岐に亘る技術を扱う分野として、これからも不可欠なものと考えられています。

本国際会議は銅・低誘電率多層配線構造の台頭と時を同じくし、1998年に IEEE Electron Devices Society の協賛の下、第1回会議が米国・サンフランシスコ空港近郊のバーリングゲーム市にて開催されました。2009年からは開催地を欧州・アジア、北米間を往来することとなり、2009年は札幌、2013年は京都で開催され、2021年は再び京都で開催されることが決まりました。これは、配線技術に対する日本の関心の高さが評価されたものであり、この京都会議を是非とも成功させる必要があります。本会議では、関連する国内外の大学、研究機関、産業界の研究者、技術者が一同に会し、材料物性、微細構造物性、これらの制御、評価、信頼性などに関して、理論、実験両面から議論を重ねる場とし、この分野の今後の学問的、技術的進展に寄与していきたいと考えております。

本会議では、この業界でともに活動を進める皆さんと強力な信頼関係を築くべく、広く装置・材料メーカー様を始めとして、関係企業の皆様にスポンサーをお願いする次第です。

誠に恐縮ではございますが、今回のスポンサーの負担金は、一口 250,000 円とさせていただきます。別表のように、拋出いただいた口数に応じ、展示ブース、謝辞ボードの表示、学会参加割引等を用意しております。詳しくは次頁をご参照ください。

学会の名称：International Interconnect Technology Conference

開催日：2021年7月6日（火）～9日（金）

開催場所：京都リサーチパーク（京都市下京区中堂寺南町134番地）

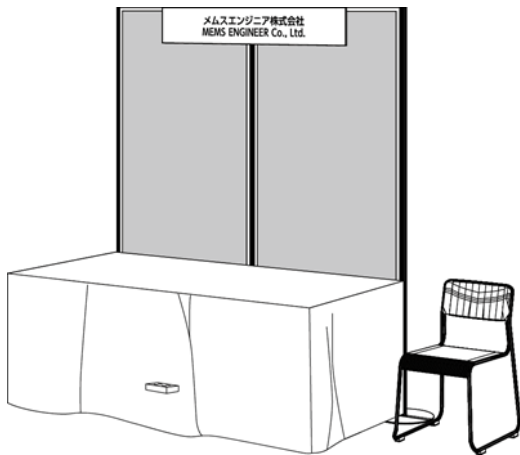
銀行：三井住友銀行

支店名： 本店営業部
 口座： 普通預金口座 9481469
 振込先名称： 株式会社セミコンダクタポータル

抛出口数と特典：口数に応じて、以下のような特典を用意させていただきます。
 金額は外税です。

| | 1口(250,000円) | 2口(500,000円) | 3口(750,000円) |
|----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 展示ブース（下図参照ください） | ブース（間口1.8m）をおひとつ用意。 ＊ブースは希望者のみ（希望される場合はお申し出ください） ＊Virtual開催の場合：スポンサープレゼンテーション（5分） | | |
| 謝辞（展示を希望されない場合を含みます） | ご協力いただいた旨を学会のオープニングセッションで紹介及び学会会場に掲示。（ただし口数により掲示場所・期間は異なります。） ＊Virtual開催の場合：スライドにて表示 | | |
| 学会参加 | 1名様無料 | 2名様無料 | 3名様無料 |
| 参加者リスト | | 学会参加者の氏名と e-mail アドレスをお知らせします。 | |
| 予稿集等への御社名掲載 | プロシーディングス及び Website（リンク付き）への掲載 | | |

展示をされる場合は、メールリストで IITC 参加者にその開催の旨がアナウンスされます。



間口 1800mm×奥行 900mm×高さ 2100mm
 基礎小間には以下を基本パッケージとします。
 ブースイメージ図をご参照下さい。
 ・バックパネル（表面：布状）
 （間口 900mm x 高さ 2100mm、2枚連結）
 ・社名板（スミ 1色、統一書体）
 ・展示台（テーブルクロス、スカート布付）
 （間口 1800mm x 奥行 900mm x 高さ 700mm）
 ・コンセント 500W（2口付き）
 （電源コードはお持ちください）
 ・椅子 1脚
 バックパネルへの掲示につきましては、ピン・画鋲、パーティションフック（2.6cm幅）等をご利用頂けます。（両面テープは使用不可です）
 展示可能面積：天地 1200mm x 幅 1600mm

Exhibitor Booth イメージ図（寸法は多少変わることがあります）

問合せ先：2021 IITC Supplier Relation

アジア地区担当 永井 洋之（東京エレクトロン株式会社）

Tel: 0551-23-4063

Email: hiroyuki.nagai@tel.com

敬具